证券代码:688432 证券简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司
2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

第一节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	39,682.10	25,565.14	28,618.00	38.66	106,162.79	74,656.63	83,468.08	27.19
利润总额	25,023.34	7,008.33	6,465.89	287.01	42,931.35	22,034.87	21,426.72	100.36
归属于上市公司股东的净利润	22,896.40	5,008.33	4,848.35	372.25	36,178.92	15,611.80	15,414.54	134.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,265.26	2,561.85	2,613.73	101.45	14,148.72	9,918.39	9,956.23	42.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	24,798.59	20,104.26	22,160.47	11.90
基本每股收益(元/股)	0.1836	0.0403	0.0390	371.24	0.2902	0.1255	0.1239	134.20
稀释每股收益(元/股)	0.1834	0.0402	0.0390	370.91	0.2899	0.1254	0.1239	134.08
加权平均净资产收益率(%)	4.89	1.15	1.10	增加3.79个百分点	7.80	3.56	3.52	增加4.28个百分点
研发投入合计	1,672.65	2,547.17	2,547.17	-34.33	6,017.45	6,968.70	6,968.70	-13.65
研发投入占营业收入的比例(%)	4.22	9.96	8.90	减少4.68个百分点	5.67	9.33	8.35	减少2.68个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	656,763.45	549,445.93	565,309.13	16.18
归属于上市公司股东的所有者权益	479,577.12	452,081.87	451,713.00	6.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2026年1月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《有研半导体硅材料股份公司关于收购株式会社DG Technologies股权进展暨收购完成的公告》(公告编号2026-003)。本次收购标的股权转让已完成,公司持有DG Technologies 70%的股权,对其财务和生产经营实施控制,本次收购属于同一控制下企业合并,故对上年同期和上年度末比较数据进行重述。

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	312,831.05	322,818.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,847,144.73	29,658,459.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,116,727.40	39,884,199.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	169,756,242.94	169,756,242.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-870,894.86	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,727.79	708,211.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,486,666.72	13,349,661.54	
少数股东权益影响额(税后)	1,290,564.31	5,807,412.69	
合计	176,311,442.88	220,301,962.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	38.66	本报告期市场需求增加,且随着公司募投项目完成,产能释放,产销量增加,销售收入增加。
利润总额_本报告期	287.01	一方面,本报告期,公司受让安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权,收购对价与应享有的被合并方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为营业外收入计入当期损益;同时,市场需求增加,且随着公司募投项目完成,产能释放,产销量增加,利润增加。
利润总额_年初至报告期末	100.36	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	372.25	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	134.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	101.45	市场需求增加,且随着公司募投项目完成,产能释放,产销量增加,利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	42.11	
基本每股收益(元/股)_本报告期	371.24	本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	134.20	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	370.91	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	134.08	
研发投入合计_本报告期	-34.33	本报告期研发活动支出减少所致。

第二节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.77	0	0	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	314,590,400	25.16	0	0	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.43	0	0	无	0
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,751,227	1.58	0	0	无	0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	14,319,986	1.15	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,514,103	0.76	0	0	无	0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	8,559,953	0.68	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,143,234	0.49	0	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,865,264	0.39	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,706,727	0.38	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	384,750,000	人民币普通股	384,750,000
株式会社RS Technologies	314,590,400	人民币普通股	314,590,400
中国有研科技集团有限公司	230,422,500	人民币普通股	230,422,500
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	19,751,227	人民币普通股	19,751,227
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	14,319,986	人民币普通股	14,319,986
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	9,514,103	人民币普通股	9,514,103
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	8,559,953	人民币普通股	8,559,953
香港中央结算有限公司	6,143,234	人民币普通股	6,143,234
国泰海通证券股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,865,264	人民币普通股	4,865,264
中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,706,727	人民币普通股	4,706,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

第三节 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2026年9月11日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》,拟以发行股份及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业(有限合伙)购买山东有研艾斯半导体材料有限公司合计71.89%的股权;同时,公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司购买山东有研半导体材料有限公司14.98%的股权。收购上述股权将同步募集配套资金。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。具体内容详见公司于2026年9月12日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

第四节 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,113,546,596.92	680,311,970.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,620,232,239.72	1,910,302,191.79
衍生金融资产	20,403,196.88	
应收票据	64,340,392.70	68,497,962.62
应收账款	334,155,441.46	311,388,568.88
应收款项融资	176,300,447.04	90,341,764.46
预付款项	28,127,123.01	52,173,120.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,684,139.47	5,830,944.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,185,965.36	256,138,779.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,647,279.23	11,930,796.18
流动资产合计	3,702,622,821.79	3,386,916,098.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,772,951.19	686,711,374.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,363,361,818.75	1,353,740,574.73
在建工程	378,048,608.91	60,959,700.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,667,741.75	20,318,215.48
无形资产	110,375,348.99	87,033,194.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,560,226.61	9,474,999.23
递延所得税资产	48,641,790.20	17,166,826.47
其他非流动资产	99,583,151.89	770,281.80
非流动资产合计	2,865,011,638.29	2,266,175,166.67
资产总计	6,567,634,460.08	5,653,091,264.75
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,971,806.48	46,555,914.88
应付账款	245,359,472.29	228,003,740.89
预收款项		
合同负债	391,403.65	2,628,146.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,384,870.64	38,393,967.05
应交税费	24,713,612.82	12,229,580.08
其他应付款	189,050,507.16	148,925,859.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,199,068.61	14,148,989.53
其他流动负债		
流动负债合计	561,070,741.65	490,886,197.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,428,678.99	9,529,889.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	173,935,410.38	12,768,274.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,485,707.29	136,072,234.60
递延所得税负债	831,009.12	35,829.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,680,805.78	158,406,228.64
负债合计	854,751,547.43	649,292,426.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,250,301,858.00	1,250,301,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,295,260,550.20	2,310,702,468.62
减:库存股	35,935,687.59	35,935,687.59
其他综合收益	-3,563,275.28	-3,378,729.54
专项储备	10,983,005.91	9,933,457.07
盈余公积	40,023,401.77	40,023,401.77
一般风险准备		
未分配利润	1,238,701,364.13	945,483,273.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,795,771,217.14	4,517,130,041.68
少数股东权益	917,111,695.51	486,668,796.53
所有者权益(或股东权益)合计	5,712,882,912.65	5,003,798,838.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,567,634,460.08	5,653,091,264.75

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,061,627,873.33	834,680,823.23
其中:营业收入	1,061,627,873.33	834,680,823.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,556,915.49	669,945,292.25
其中:营业成本	711,417,693.81	543,008,429.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,265,220.30	11,587,522.92
销售费用	15,751,590.36	13,217,361.56
管理费用	41,772,795.27	38,230,196.96
研发费用	60,174,484.72	69,687,038.63
财务费用	3,175,131.03	-5,785,256.94
其中:利息费用	1,279,026.27	641,985.11
利息收入	7,247,926.25	7,607,022.13
加:其他收益	43,876,292.94	61,577,086.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,915,123.89	-8,689,501.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-41,183,722.32	-35,684,510.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	21,615,600.98	1,451,855.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-448,573.22	-999,757.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,672,963.11	-5,191,847.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	341,246.00	77,610.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	258,867,437.54	212,960,976.27
加:营业外收入	170,466,919.34	1,525,422.95
减:营业外支出	20,892.27	219,198.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	429,313,464.61	214,267,200.33
减:所得税费用	39,067,528.61	32,854,001.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	390,245,936.00	181,413,198.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	390,245,936.00	181,413,198.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	361,789,178.13	154,145,387.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,456,757.87	27,267,811.43
六、其他综合收益的税后净额	-263,636.77	268,320.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,545.74	187,824.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-184,545.74	187,824.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-184,545.74	187,824.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,091.03	80,496.02
七、综合收益总额	389,982,299.23	181,681,518.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	361,604,632.39	154,333,211.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,377,666.84	27,348,307.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2902	0.1239
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2899	0.1239

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-870,894.86元,上期被合并方实现的净利润为:-2,464,337.43元。

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	854,730,944.10	651,890,161.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,377,271.69	15,173,816.99
收到其他与经营活动有关的现金	30,860,041.54	31,508,414.14
经营活动现金流入小计	898,968,257.33	698,572,392.22
购买商品、接受劳务支付的现金	395,265,309.08	241,461,234.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	165,679,228.78	150,467,106.02
支付的各项税费	50,274,771.10	53,795,332.10
支付其他与经营活动有关的现金	39,763,036.21	31,244,059.41
经营活动现金流出小计	650,982,345.17	476,967,732.26
经营活动产生的现金流量净额	247,985,912.16	221,604,659.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,045,000,000.00	5,845,400,000.00
取得投资收益收到的现金	19,550,954.61	25,104,047.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,276.15	105,000.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	342,868,463.08	14,846,985.52
投资活动现金流入小计	6,407,424,693.84	5,885,456,033.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,016,971.77	93,063,361.30
投资支付的现金	5,761,000,000.00	5,960,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,716,895.18	25,802,180.24
投资活动现金流出小计	6,090,733,866.95	6,078,865,541.54
投资活动产生的现金流量净额	316,690,826.89	-193,409,508.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,800,000.00
偿还债务支付的现金	7,984,598.35	12,235,759.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,689,067.08	85,871,827.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,980,320.00	11,081,796.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,288,070.15	6,361,808.23
筹资活动现金流出小计	133,961,735.58	104,469,395.21
筹资活动产生的现金流量净额	-133,961,735.58	-94,669,395.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,482,639.35	-366,215.53
五、现金及现金等价物净增加额	421,232,364.12	-66,840,459.25
加:期初现金及现金等价物余额	631,735,417.74	914,906,385.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,967,781.86	848,065,926.54

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月27日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-048

有研半导体硅材料股份公司
关于变更回购股份用途并注销
暨变更注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")拟将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股已回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"及"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并减少注册资本"。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为3,555,336股,约占公司当前总股本比例的0.28%。注销完成后公司的总股本将由1,250,301,858股减少为1,246,746,522股,注册资本将由1,250,301,858元减少为1,246,746,522元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《有研半导体硅材料股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的事项尚需提交股东会审议通过后实施。

公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"及"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并减少注册资本",并同步变更注册资本、修改《公司章程》。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后实施,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币15.53元/股(含);回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元(含);本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内;本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见2024年2月21日和2024年2月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-007)和《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-009)。

2024年4月30日,公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,555,336股,约占公司总股本的比例为0.28%,回购的最高价为10.70元/股,最低价为8.50元/股,回购均价为10.11元/股,已支付的总金额为35,931,966.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年5月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于回购完成暨回购实施结果的公告》(公告编号:2024-026)。

截至本公告披露日,公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益、增强投资者回报能力和水平,提振投资者的投资信心,结合公司实际发展情况等综合因素,公司拟将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股股票用途由"用于员工持股计划或股权激励"及"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,250,301,858股变更为1,246,746,522股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	注销前		注销股份数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	1,250,301,858	100.00	3,555,336	1,246,746,522	100.00
其中:回购专用证券账户	3,555,336	0.28	3,555,336	0	0.00
总股本	1,250,301,858	100.00	3,555,336	1,246,746,522	100.00

注:上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为3,555,336股,约占公司当前总股本比例的0.28%。公司总股本预计将由1,250,301,858股变更为1,246,746,522股,注册资本预计将由人民币1,250,301,858元变更为人民币1,246,746,522元。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件,亦不会改变公司的上市地位。

六、变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

鉴于上述回购注销事项,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,250,301,858元(以下如无特别指明,均为人民币元)。	第六条 公司注册资本为人民币1,246,746,522元(以下如无特别指明,均为人民币元)。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,250,301,858股,公司的股本结构为:普通股1,250,301,858股,无其他种类股票。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,246,746,522股,公司的股本结构为:普通股1,246,746,522股,无其他种类股票。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

七、相关决策程序

公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-049

有研半导体硅材料股份公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目"8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化"达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月,本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号),同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)187,143,158股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币185,458.87万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月7日出具《验资报告》(毕马威华振验字第2201588号)。

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2022年11月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2026年9月30日,公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具体投入情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金累计投入比例
承诺投资项目				
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	38,482.43	36,364.64	94.50%
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	23,812.76	19,545.64	82.08%
3	集成电路用8英寸硅片再扩产项目	11,922.00	5,392.50	45.23%
4	补充研发与营运资金	25,782.81	24,781.47	96.12%
小计		100,000.00	86,084.25	86.08%
超募资金投向				
1	超募资金永久补流	38,500.00	38,500.00	100.00%
2	股份回购	3,593.57	3,593.57	100.00%
3	8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化	4,833.00	757.60	15.68%
4	大尺寸半导体硅单晶基地建设项目	19,470.15	4,568.17	23.46%
小计		66,396.72	47,419.34	71.42%
合计		166,396.72	133,503.59	80.23%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的情况

结合公司当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目预计达到可使用状态时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态时间	变更后项目达到预定可使用状态时间
1	8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化	2026年12月	2027年12月

(二)本次募投项目延期的原因

公司对募投项目"8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化"的达到预定可使用状态时间予以调整,主要系半导体设备关键零部件交付周期延长,导致设备整机到货时间延后所致。公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,将"8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化"项目达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,没有改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

2026年10月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将"8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化"项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见,该事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-050

有研半导体硅材料股份公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"或"有研硅")及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金(含超募资金)投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等,且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额:不超过人民币40,000万元(含本数)

● 已履行的审议程序:公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司及子公司计划使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号),有研半导体硅材料股份公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币185,458.87万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币166,396.72万元,以上募集资金毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月7日出具《验资报告》(毕马威华振验字第2201588号),对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年11月7日		
募集资金总额	185,458.87万元		
募集资金净额	166,396.72万元		
超募资金总额	□不适用 ☑适用,66,396.72万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)(注1)	达到预定可使用状态时间
	集成电路用8英寸硅片扩产项目	94.50 (注2)	2025年12月
	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	82.08	2026年12月
	集成电路用8英寸硅片再扩产项目	45.23	2026年12月
	补充研发与营运资金	96.12	不适用
	永久补流	100.00	不适用
	股份回购	100.00	不适用
	8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化	15.68	2027年12月
	大尺寸半导体硅单晶基地建设项目	23.46	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注1:表中"累计投入进度"为截至2026年9月30日数据。

注2:"集成电路用8英寸硅片扩产项目"已于2025年12月结项,截至2026年9月30日投入进度为94.50%,系部分尾款尚未结清等。

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)投资方式及投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币40,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不会存在变相改变募集资金用途的行为,不构成关联交易。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	185,500	185,500	490.42	0
2	其他:通知存款	20,000	20,000	7.50	0
合计				497.92	0
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				46,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.18	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				219.80	
募集资金总投资额度(万元)				50,000	
目前已使用的投资额度(万元)				0	
尚未使用的投资额度(万元)				50,000	

注:表中"实际投入金额"、"实际收回本金"为最近12个月内滚动使用后的累计额。

二、审议程序

公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币40,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(二)公司拟采用的会计政策及核算原则

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定及公司现金管理产品的业务模式及合同现金流情况,公司将现金管理产品分类:

1、购买的结构性存款产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"科目核算,购买日至报表日之间的公允价值变动在"公允价值变动损益"科目核算,到期后将实际收益扣除已计提的公允价值变动金额,计入"投资收益"科目。

2、购买的通知存款产品分类为以摊余成本计量的金融资产,在"交易性金融资产"科目核算,存款到期支取后相关收益计入"利息收入"科目。

具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:有研硅及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,公司履行了必要的程序,符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,保荐机构对有研硅及其子公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-044

有研半导体硅材料股份公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月20日以电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《有研半导体硅材料股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司编制了2026年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(普华永道中天审字(2026)第10003号),计算公司2025年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为4.04亿元,达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为50%。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《激励计划实施考核管理办法》")等相关的规定,公司对激励对象进行了2025年度绩效考核。其中,本激励计划首次授予部分第二个行权期的激励对象中,有67名激励对象的年度绩效考核结果为"A",24名激励对象的年度绩效考核结果为"B",1名激励对象因离职不可行权;预留授予部分第一个行权期的激励对象中,有28名激励对象的年度绩效考核结果为"A",6名激励对象的年度绩效考核结果为"B"。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

(三)审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《激励计划(草案)》规定,鉴于在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司发生派息的情况,股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的调整。经本次调整后,行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

(四)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《激励计划(草案)》及《激励计划实施考核管理办法》等相关规定,2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就。其中,首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象合计91名,可行权股票期权164.10万份;预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象合计34名,可行权股票期权12.96万份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

(五)审议通过《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》

本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期,公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值,可行权比例为50%;部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权;首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上,公司拟注销的股票期权合计198.24万份。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

(六)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司拟将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股股票用途由"用于员工持股计划或股权激励"及"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续。本次注销后,公司总股本将由1,250,301,858股减少为1,246,746,522股,注册资本将由1,250,301,858元减少为1,246,746,522元。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

(七)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币40,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将募集资金投资项目"8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化"达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,公司修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等9项制度。

9.1《董事会议事规则》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.2《独立董事工作制度》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.3《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.4《股东会议事规则》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.5《募集资金管理制度》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.6《董事会秘书工作规则》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.7《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.8《独立董事年报工作制度》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.9《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日